（上接B064版）

作为Fabless模式企业，技术创新和工艺设计能力是美国豪威的核心竞争力，美国豪威核心管理团队具有丰富的行业经营管理经验，对CMOS图像传感器行业特点和技术发展趋势有着较为深刻的理解，在技术研发和工艺技术改进等方面具有较强的前瞻性。美国豪威管理层对未来几年技术研发路径有着较为清晰的规划，研发人员占比较高，近两年一期研发投入较为稳定，具备较为高效的新技术、新工艺和新产品研发能力。

公司已在预案（修订稿）“第四节交易标的基本情况”之“二、交易标的之北京豪威”之“（六）北京豪威主营业务情况”补充披露了上述内容。

（4）风险提示

公司已在重组预案（修订稿）“重大风险提示”之“二、标的资产经营风险”补充披露了“九、业绩增长可持续性具有不确定性和风险”。具体如下：

“标的业绩是否增长，即受标的公司产品技术先进性、经营管理能力、营销力量等因素的影响，又受市场需求变动、市场竞争情况、国际贸易环境、原材料和外协厂商价格波动等因素的影响。标的公司管理层将按经营规划努力实现较好的业绩，但由于影响因素较多，并且很多因素变动的不确定性较高，因此标的业绩增长的可持续性具有一定的不确定性。”

6、中介机构意见

独立财务顾问认为：美国豪威是全球最主要三家CMOS图像传感器制造企业之一，具有较为显著的行业地位和品牌知名度；报告期内，美国豪威研发投入持续、稳定，拥有坚实的研发团队和较为充分的技术储备，具备持续创新能力；报告期内，美国豪威同主要客户缔结了较为稳定的合作关系，前五大客户收入占比较高且变动较小；报告期内，美国豪威积极调整产品结构，CMOS图像传感器产品毛利率逐年提高，盈利能力不断增强，美国豪威未来业绩增长具备可持续性。

（五）预案披露，本次交易拟募集配套资金不超过20亿元，用于标的公司晶圆测试及晶圆重构生产线项目、硅基液晶投影显示芯片扩产项目建设。请公司补充披露：（1）募投项目的实施主体及募资资金投入方式；（2）募投项目是否需要并且已经取得相关许可或审批，是否具备相关制造工艺的技术储备，是否存在其他实质性障碍。请财务顾问发表意见。

【回复】

1、募投项目的实施主体及募资资金投入方式

晶圆测试及晶圆重构生产线项目由北京豪威下属子公司豪威半导体实施。项目实施地点为上海市松江出口加工区茸华路，该项目预计总投资183,919.98万元。本次募集资金到位后，韦尔股份将通过增资、借款或法律法规允许的其他方式将资金投入豪威半导体。

硅基液晶投影显示芯片扩产项目由北京豪威下属子公司豪威半导体实施。项目实施地点为上海市松江出口加工区茸华路，该项目预计总投资22,024.36万元。本次募集资金到位后，韦尔股份将通过增资、借款或法律法规允许的其他方式将资金投入豪威半导体。

2、募投项目是否需要并且已经取得相关许可或审批，是否具备相关制造工艺的技术储备，是否存在其他实质性障碍

本次重组募投项目需要履行项目备案、环境影响评价手续，项目均在豪威半导体现有土地、房屋上实施。目前，募投项目可研报告已基本编制完成，随后豪威半导体将申请项目备案、环评等相关审批手续。

豪威科技实施募投项目所涉及的全部核心技术均为自主研发且拥有完全自主知识产权的技术，具体情况如下：

（1）强大的研发团队和持续的研发投入，保证了工艺的领先性

美国豪威作为CMOS图像传感器行业领先企业，多年以来通过自主研发已经形成了系统化的研发体系，培养并储备了一批具有较强技术能力和创新精神的研发人员。北京豪威在美国加州、中国上海、中国台湾等地有强大的研发团队，截至2018年5月31日，研发人员共870人，团队中的核心技术人员均在全球知名半导体公司担任过技术、运营等高层管理人员，现均为北京豪威核心管理人员。

2016-2017年，豪威科技研发投入均超过11亿元，占营业收入的比例均超过12%，充足合理的研发投入保证了技术的先进性、工艺的领先性和产品的市场竞争力。

（2）专利数量快速增长

报告期内，豪威科技持续致力于开发前沿技术，以进一步提升在图像传感器行业的竞争地位，全球专利数量（包括部分正在申请中的专利）从2016年末的3,190项增加至的2017年末的3,795项，2018年5月末增加到4,060项。截至2018年5月31日，豪威科技拥有的集成电路布图设计证书共9项。

（3）项目相关的技术支持

①晶圆测试及晶圆重构生产线项目

豪威科技在CMOS图像显示芯片领域拥有高端的自主技术，包括芯片的设计开发与测试、销售服务等，拥有FSI、OmniBSI、OmniBSI-2、PureCel四种尖端的像素技术，为客户在图像性能和专业传感器方面提供了广泛的选择。豪威半导体与设备供应商合作开发用于图像感应芯片图像测试的测试机，并自主开发测试软件，目前豪威半导体拥有超过100台套的16 site共同测试的测试机，年测试量达到8-9亿颗。该项目的晶圆测试是针对高像素感应芯片的晶圆进行探针测试，豪威科技拥有自主研发的测试软件，进行晶圆测试时完全可达到高质量的测试结果，满足客户的需求。

在目前的图像感应芯片供应链中，经过测试后的晶圆会按照不同的客户端需求分两条后道流程进行。其中一条后道程序为进行晶圆级的封装，经过封装切割后即为目前豪威半导体测试中的图像感应芯片；另一条后道流程为晶圆重构封装，将测试后的晶圆进行打磨、切割、清洗、分选，将所有良品重新拼装成一张全良品的晶圆提供给客户。目前，虽然豪威科技的晶圆重构采取委外加工的方式，但其下属台湾子公司拥有专属工程团队驻厂配合工艺制程技术支持，豪威科技及其子公司完全有能力自主新建晶圆重构生产线。豪威半导体晶圆重构的主要工艺流程如下：

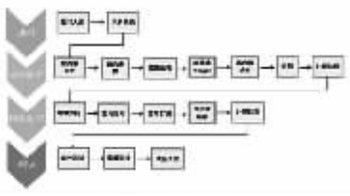
②硅基液晶投影显示芯片扩产项目

LCOS，即液晶附硅，也叫硅基液晶，是一种基于反射模式，尺寸非常小的矩阵液晶显示装置。此投影技术采用涂有液晶硅的CMOS集成电路芯片作为反射式LCD的基片。用先进工艺磨平后镀上铝当作反射镜，形成CMOS基板，然后将CMOS基板与含有透明电极之上的玻璃基板相贴合，再注入液晶封装而成。LCOS将控制电路放置于显示装置的后面，可以提高透光率，从而达到更大的光输出和更高的分辨率。

该项目生产的LCOS芯片组为微型投影系统提供了一个高解析度（HD）、外形紧凑、低功耗和低成本的微型显示器解决方案。凭借可提供先进图像处理和主机附加功能的同伴芯片支持，该单板LCOS芯片可提供720p的高清视频。与此同时，该同伴芯片简化了系统设计，节省了空间并有效降低了能耗，且采用全数字技术制作出清晰、稳定的图像。上述特征使得该LCOS芯片为下一代投影系统提供了一个极具吸引力的解决方案，能广泛应用于可穿戴电子设备、移动显示器、微型投影、汽车和医疗机械等领域。

LCOS芯片的生产可分为前道的半导体CMOS集成电路制造及后道的液晶面板贴合封装制造。前道的半导体CMOS制造，豪威科技已有成熟的设计、仿真、制作及测试技术，良品率高、成本低；由于液晶面板制造已发展的相当成熟，后道的液晶面板贴合封装制造不存在技术难点。目前，豪威半导体已经建成了全球首条12吋LCOS硅基液晶投影显示芯片生产线，可实现年产LCOS芯片60万颗。

该项目产品的生产流程主要包括进料、成盒制程、模组制成及测试环节，具体过程如下图所示：



豪威科技实施本次募投项目不存在实质性障碍。

公司已在预案（修订稿）“第六节发行股份情况”之“三、本次募集配套资金的合理性分析”之“（二）募集配套资金用途”补充披露了上述内容。

3、中介机构意见

独立财务顾问认为：豪威科技子公司豪威半导体正在申请项目备案、环评相关审批手续，本次募集资金到位后，韦尔股份将通过增资、借款或法律法规允许的其他方式将资金投入豪威半导体；豪威科技实施募投项目所涉及的全部核心技术均为自主研发且拥有完全自主知识产权的技术，具备相关制造工艺的技术储备，不存在实质性障碍。

（六）公司于2017年5月上市，2017年扣非后归母净利润为1.21亿元，同比下滑5.09%。请公司补充披露：（1）上市公司上市后业绩下滑的主要原因及对公司持续经营的影响；（2）目前上市公司实际控制人及其一致行动人的质押股份数量、占公司总股本比例、质押目的及资金使用情况；（3）本次交易完成后对标的公司的具体整合计划，包括是否调整其董事会构成、经营管理决策程序、财务制度等；（4）公司是否具备整合标的公司所需的相关人员、技术和管理储备，并详细披露交易标的与上市公司原有业务、资产、财务、人员、管理等方面的整合风险；（5）结合标的公司的业务领域、下游客户等，分析说明本次交易是否存在显著可量化的协同效应，以及本次交易对未来上市公司业绩的具体影响。请财务顾问发表意见。

【回复】

1、上市公司上市后业绩下滑的主要原因及对公司持续经营的影响

2017年，公司实现营业总收入24.06亿元，同比增长11.35%；归属于上市公司股东的净利润1.37亿元，同比下滑3.20%，业绩下滑的主要原因是2017年限制性股票股权激励费用的摊销影响。剔除公司2017年限制性股票股权激励摊销费用的影响，归属上市公司股东的净利润1.59亿元，同比增长12.36%。

2018年上半年，公司实现营业总收入18.95亿元，同比增长107.26%；归属于上市公司股东的净利润1.56亿元，同比增长164.90%；剔除公司2018年限制性股票股权激励摊销费用的影响，归属上市公司股东的净利润2.67亿元，同比增长354.70%。

公司上市后，经营业绩稳步快速增长，持续盈利能力进一步增强。

公司已在预案（修订稿）“第二节上市公司基本情况”之“六、主要财务指标”补充披露了上述内容。

2、目前上市公司实际控制人及其一致行动人的质押股份数量、占公司总股本比例、质押目的及资金使用情况

目前，上市公司实际控制人虞仁荣持有公司股份 279,435,000 股，占公司总股本的61.30%；累计质押股份数量为 183,810,205 股，占其持股总数的65.78%，占公司总股本的 40.33%。股票质押融资主要用于韦尔股份员工股权激励计划的借款及实际控制人对外股权投资。

公司已在预案（修订稿）“第二节上市公司基本情况”之“九、上市公司股份质押情况”补充披露了上述内容。

3、本次交易完成后对标的公司的具体整合计划，包括是否调整其董事会构成、经营管理决策程序、财务制度等

（1）北京豪威

北京豪威目前根据《中外合资经营企业法》制定了决策程序和相关规章制度。公司董事长虞仁荣自2017年9月20日起担任北京豪威董事，并于2017年9月29日担任北京豪威总经理兼首席执行官；公司董事、财务总监、董事会秘书贾渊自2018年4月28日起担任北京豪威董事；公司证券事务代表任冰自2018年7月20日起担任北京豪威监事。

本次交易完成后，北京豪威相关制度将根据《公司法》、《上市公司治理准则》、韦尔股份《控股子公司管理制度》等相关法规和内控管理制度进行修订和调整。由于美国豪威成立于1995年，已建立了较为完善严谨的经营管理决策程序和内部控制制度，在其长期经营中已充分证明了该内部制度的有效性，因此不会大幅调整。

上市公司将在财务上对北京豪威实行统一管理，不断规范日常经营活动中财务运作，降低财务风险，同时提高上市公司体系资金使用效率，实现内部资源的统一管理及优化配置。

（2）思比科、视信源

本次收购前，思比科已经按照法律法规的要求，建立了完善的法人治理结构，并规范运作。本次收购完成后，思比科将纳入上市公司管理体系，按照上市公司《控股子公司管理制度》等相关法规和内控管理制度进行修订和调整，思比科的公司治理结构将进一步完善，整体经营效率及公司治理有效性将进一步提升。

视信源作为思比科的持股公司，无实际经营。本次收购后，上市公司保证其管理层与治理层的稳定，按照目前的机构设置进行管理。

公司已在预案（修订稿）“第一节本次交易概况”之“七、本次交易对上市公司的影响”之“（六）本次交易完成后上市公司对标的公司的整合”补充披露了上述内容。

4、公司是否具备整合标的公司所需的相关人员、技术和管理储备，并详细披露交易标的与上市公司原有业务、资产、财务、人员、管理等方面的整合风险

（1）公司具备整合标的公司所需的相关人员、技术和管理储备

本次交易后，上市公司将维持标的公司原有经营管理团队和业务团队的相对稳定，标的公司核心管理及技术团队成员将全部留任，维持独立经营状态，韦尔股份将参与标的公司的重大经营决策。

韦尔股份是国内少数集半导体产品设计及分销业务为一体的上市公司，根据上市公司未来发展战略布局，本次交易完成后，韦尔股份将对豪威科技及思比科进行业务分工，韦尔股份、豪威科技、思比科三个公司在业务、技术、研发、销售渠道、产业链等方面高度协同，具体协同效应请见本回复“（三）1、（2）公司购买标的的主要考虑”之“①韦尔股份、豪威科技、思比科三者之间具有较强的协同效应”。

公司已在预案（修订稿）“第一节本次交易概况”之“七、本次交易对上市公司的影响”之“（六）本次交易完成后上市公司对标的公司的整合”补充披露了上述内容。

（2）业务、资产、财务、人员、管理等方面的整合风险

本次交易存在交易标的与上市公司在业务、资产、财务、人员、管理等方面的整合风险，具体包括：

在业务方面，尽管上市公司已制定了切实的整合计划，但进入新的细分领域仍面临着一定的风险。上市公司原有业务与新业务之间能否达到最佳协同效果、能否达到预期最佳效果所需的时间存在一定的不确定性。

在资产方面，本次交易完成后，标的公司将继续保持资产的独立性，上市公司将根据自身过往对资产要素的组合、配置和调整的经验基础，进一步优化资源配置，提高资产利用效率，增强企业的核心竞争能力。但若标的公司的管理制度与内控体系在重组完成后无法及时调整和完善，公司将面临资产整合效果不佳的风险。

在财务方面，本次收购完成后，上市公司将根据上市公司规范运作的相关要求将标的公司纳入统一财务管理体系中，加强对标的公司财务运作等重大事项方面的管理与控制。但不排除上市公司对子公司财务管理出现失误，进而出现财务整合风险。

在人员方面，上市公司董事长于2017年9月担任北京豪威总经理兼首席执行官、美国豪威首席执行官，经过近一年的熟悉及磨合，北京豪威的核心管理层及主要技术团队成员已经相对稳定。本次交易完成后，标的公司核心管理层及主要技术成员将全部留任。但是，随着市场竞争的加剧、人才自身需求的多样化，标的公司可能仍会面临核心人才流失的风险。

在管理方面，本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的控股子公司，上市公司管理与运营难度将有所增加，在资金整合、科研开发、资本运营等方面对管理层提出更高要求，如果标的公司管理团队与上市公司管理层未能形成有效配合，可能对上市公司带来一定的管理风险。此外，美国豪威与本公司在法律法规、会计税收制度、商业管理、公司管理制度、企业文化等经营管理方面存在一定差异，对标的公司的整合效应显现尚需一定时间。本公司将通过不断完善公司治理、加强内部控制、提高公司管理水平等措施降低该等风险，并对相关情况进行真实、准确、完整、及时、公平的披露，提醒广大投资者关注本次交易上市公司的整合风险。

公司已在预案（修订稿）“重大风险提示”之“三、（一）收购整合风险”中补充披露了上述内容。

5、结合标的公司的业务领域、下游客户等，分析说明本次交易是否存在显著可量化的协同效应，以及本次交易对未来上市公司业绩的具体影响

本次交易完成后，上市公司将与标的公司存在较强的协同效应，具体请见本回复“（三）1、2公司购买标的的主要考虑”之“①韦尔股份、豪威科技、思比科三者之间具有较强的协同效应”。

协同效应主要体现在业务、技术、研发、销售渠道、产业链等方面，这些协同效应将最终体现为经营效率的提高、成本的下降、未来上市公司经营业绩的提高，而在资产评估中是无法量化体现的。

公司已在预案（修订稿）“第一节本次交易概况”之“七、本次交易对上市公司的影响”之“（七）上市公司与标的公司的协同效应”补充披露了上述内容。

6、中介机构意见

独立财务顾问认为：韦尔股份上市后，经营业绩稳步快速增长，持续盈利能力进一步增强；已在重组预案中披露了上市公司实际控制人及其一致行动人的质押股份数量、占公司总股本比例、质押目的及资金使用情况，本次交易完成后对标的公司的具体整合计划；韦尔股份具备整合标的公司所需的相关人员、技术和管理储备，并详细披露了整合风险；韦尔与标的公司存在较强的协同效应，协同效应主要体现在业务、技术、研发、销售渠道、产业链等方面，这些协同效应将最终体现为经营效率的提高、成本的下降、未来上市公司经营业绩的提高，而在资产评估中是无法量化体现的。

（七）预案未披露并购重组后对标的资产核心管理团队以及研发技术人员的安排。请公司补充披露：（1）标的资产人员结构、核心技术人员及管理团队的教育背景、从业经历，近两年一期高管以及核心技术研发人员的流动情况，如在职人数，离职率等指标。（2）本次交易完成后核心管理团队以及研发技术人员的安排意向，请就核心人员变动对公司生产经营的影响提示风险。请财务顾问发表意见。

【回复】

1、标的资产人员结构、核心技术人员及管理团队的教育背景、从业经历，近两年一期高管以及核心技术研发人员的流动情况，如在职人数，离职率等指标

（1）北京豪威

北京豪威主要经营主体为美国豪威，因此下述人员结构、核心技术人员及管理团队的教育背景、从业经历，近两年一期高管以及核心技术研发人员的流动情况等均以美国豪威口径披露。

①人员结构

截至2018年5月31日，美国豪威人员结构如下：

A.教育程度

项目	本科	硕士	博士	其他	合计数
人数	567	592	105	274	1,538
占比（%）	36.87	38.49	6.83	17.82	100.00

B.所属部门

项目	行政管理	研发部	市场营销	产品部	合计数
人数	145	870	207	316	1,538
占比（%）	9.43	56.57	13.46	20.55	100.00

②核心技术人员变动及简历

姓名	职务和教育背景	是否任职			离职原因
		2016年	2017年	2018年1-5月	
Grant, Lindsay Alexander	现任工艺工程副总裁，圣安德鲁斯大学物理本科学位	是	是	是	—
Tai, Dyson Hsin-Chih	现任工艺整合副总裁，台湾交通大学材料工程与科学硕士学位	是	是	是	—
Lin, Peng	现任算法及软件副总裁，北京大学数学硕士学位以及华盛顿大学数学博士学位	是	是	是	—
Dai, Tiejun,	现任设计工程副总裁，清华大学硕士学位	是	是	是	—
Huang, Wei-Feng	现任设计工程副总裁，台湾逢甲大学工程学士学位	是	是	是	—
Shan, Qingwei	现任工程副总裁，清华大学工程硕士学位	是	是	是	—
Manabe, Sohei	现任像素设计高级总监，日本大阪大学电子工程硕士学位	是	是	是	—
Solhusvik, Johannes	现任欧洲设计中心总经理，电子工程硕士学位以及CCD/CMOS传感器设计博士学位	是	是	是	—
Mabuchi, Keiji	现任像素设计技术总监，东京大学应用物理本科学位以及名古屋大学物理硕士学位	是	是	是	—
Mao, Duli	现任工程整合高级总监，普林斯顿大学电子工程硕士及博士学位	是	是	是	—
Funatsu, Eiichi	现任首席技术官办公室高级总监，东京大学电子工程博士学位	是	是	是	—
Fowler, Boyd	现任首席技术官，美国斯坦福大学电子工程硕士及博士学位	是	是	是	—
Rhodes, Howard	原首席技术官	是	否	否	去世
Mo, Yaowu	原产品设计高级总监	是	否	否	离职

报告期内，美国豪威核心技术人员总计14人，且较为稳定。截至2018年5月31日，美国豪威两年一期内离职的核心技术人员总计2人，流失率为14.29%。

公司已在预案（修订稿）“第四节交易标的基本情况”之“二、交易标的之北京豪威”之“（六）北京豪威主营业务情况”补充披露了上述内容。

③高级管理人员简历

截至2018年5月31日，美国豪威高级管理人员总计12名，具体情况如下：

虞仁荣先生，现任美国豪威董事、首席执行官。兼任北京豪威董事、总经理兼首席执行官，北京豪威亦庄科技有限公司执行董事，韦尔股份董事长，北京京鸿志执行董事，深圳京鸿志执行董事，香港华清董事长，北京泰合志恒董事长，无锡中普微董事长，武汉果核科技有限公司董事，上海京恩资产管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，武汉韦尔半导体有限公司董事长，山东新恒汇电子科技有限公司董事，青岛清恩资产管理有限公司监事。

Yang, Hongli先生，清华大学电子工程学博士，现任美国豪威董事、总裁兼首席运营官。1996年加入美国豪威，曾任工程总监；2007年起担任美国豪威工程副总裁；2012年2月至今担任美国豪威首席运营官。

Chan, Anson先生，宾夕法尼亚大学经济学和工程学双学士、芝加哥大学工商管理硕士，现任美国豪威首席财务官和财务副总裁。曾任普华永道国际会计师事务所高级经理；2006年加入美国豪威。

Wu, Chih-huei先生，密歇根州立大学材料科学与工程硕士，现任美国豪威运营副总裁。曾任PCTEL, Inc的工程副总裁；2001年加入美国豪威。

Li, Hongjun先生，复旦大学电子工程学士，现任美国豪威技术副总裁。1997年加入美国豪威，曾任美国豪威全球项目总监和高级总监。

Fowler, Boyd先生，斯坦福大学电子工程博士，现任美国豪威首席技术官。曾任Pixel Devices的创始人和工程副总裁，Fairchild Imaging公司首席技术官和工程副总裁；2015年加入美国豪威。

Wu, Xiaodong先生，天津大学电子工程硕士、美国西北大学EMBA，现任美国豪威市场营销副总裁。曾任迈威科技公司（Marvell）销售副总裁和中国区总经理，并曾任职于摩托罗拉，飞思卡尔，赛灵思、领特等知名公司；2018年1月加入美国豪威。

Grant, Lindsay Alexander先生，圣安德鲁斯大学物理学学士，现任美国豪威工程副总裁。曾任职于Seagate Technology公司，ST Microelectronics公司技术总监；2016年加入美国豪威。

Hasnain, Zille先生，华盛顿州立大学工商管理硕士，现任美国豪威质量控制副总裁。曾任Micron Technology, Inc质量保障和客户支持部门高级总监。

Huang, Wei-Feng先生，台湾逢甲大学电子机械学士，现任美国豪威设计副总裁。曾任Elitegroup Computer Systems公司CAD和CAE相关业务负责人。

Milunovic, Michelle女士，加利福尼亚大学伯克利分校机械工程硕士，现任美国豪威销售副总裁。曾任Flextronics公司高级客户工程经理，Agilent/Hewlett Packard公司全球客户经理。

Shan, Qingwei先生，清华大学电子工程硕士，现任美国豪威工程副总裁。曾任北京集成电路设计中心工程应用部门经理。

美国豪威高管团队较为稳定，2016年至2018年5月，美国豪威新增高级管理人员2人，分别为虞仁荣和Wu, Xiaodong；减少高级管理人员三人，分别为Hong, Xiaoying、Rhodes, Howard和Ray, Cisneros。

公司已在预案（修订稿）“第四节交易标的基本情况”之“二、交易标的之北京豪威”之“（三）北京豪威股权结构、人员结构及高管团队情况”补充披露了上述内容。

（2）思比科

①人员结构

截至2018年5月31日，思比科人员结构如下：

A.教育程度

项目	本科及以下	硕士	博士	合计数
人数	293	30	2	325
占比（%）	90.15	9.23	0.62	100.00

B.人员划分

项目	管理人员	研发人员	销售人员	生产人员	合计数
人数	34	55	142	94	325
占比（%）	10.46	16.92	43.69	28.92	100.00

②高级管理人员简历及变动情况

思比科共有高级管理人员7名，各人员简历如下：

陈杰先生，1963年9月出生，中国国籍，拥有日本永久居留权，中国科学院微电子研究所研究员、博士生导师，工学博士学历。1994年至2001年，历任日本国立电气通信大学副研究员、日本YOZAN公司项目主管、日本国立电气通信大学信息与系统研究生院副教授职务，从事图像处理、信号处理、数模混合集成电路设计等方面的研发工作。2001年至2004年，兼任北京六合万通微电子技术有限公司首席技术官，负责无线通信基带芯片的研发工作。2004年9月至今担任思比科董事长，2005年4月至今担任视信源董事长。2006年7月至今任广信创新微电子技术（北京）有限公司董事，2012年5月至今任太仓思比科执行董事兼总经理，2013年7月至今任天津安泰执行董事。

刘志碧先生，1979年6月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2002年7月至2004年8月在中科院微电子所参与“863”重大专题项目。2004年9月至2009年12月，担任思比科副总经理，2010年1月至今，担任思比科董事、总经理，负责思比科的运营管理工作。2011年1月至今任视信源董事。

程杰先生，1979年5月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2001年5月至2003年9月，任湖南大学应用物理系微电子教研室教师。2006年7月至今，历任思比科工程师、副总经理，负责数字部分相关的集成电路设计。现为思比科核心技术人员、董事、副总经理。

旷章曲先生，1975年2月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2001年3月至2005年5月，供职于北京六合万通微电子技术有限公司，任模拟部副部长，参加WCDMAAimonitor项目负责硬件调试，参加无线局域网11a/b/g芯片开发项目负责模拟电路部分开发，整体物理实现。2005年6月至今，任思比科模拟部部长、副总经理、董事。2011年7月至今任视信源监事，2013年7月至今任天津安泰监事。

钟萍女士，1971年3月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。1996年5月至2002年3月供职于北京测量通信总体研究所，历任程序员、高级程序员。2002年3月至2006年5月，供职于创新科技有限公司（北京研发中心），担任主任工程师。2006年7月至今，供职于思比科，担任应用系统研发部门总监，副总经理。现为思比科核心技术人员、副总经理。2011年11月至今担任天津芯络科微电子研发有限公司监事。

李红女士，1965年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1997年2月至2001年5月，就职于中建审计事务所，从事财务咨询、财务顾问、审计业务。2001年6月至2003年8月，担任北京六合万通微电子技术股份有限公司任财务主管。2003年8月至2005年8月，任北京时通网络通信有限公司综合计划部部长。2005年8月至今，任思比科财务总监。

冯军先生，1973年3月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。1997年4月至2003年7月，任华为技术有限公司上海研究所IC设计中心经理。2003年8月至2004年3月，创立上海正诺电子技术有限公司。2004年4月至2004年12月，任上海众华电子技术有限公司，研发副总裁。2004年12月至2008年8月，任芯原微电子（上海）技术股份有限公司，市场副总裁。2008年9月至2012年6月任无锡硅动力技术股份有限公司，副总经理、第二事业部总经理。2013年3月至今任思比科运营总监、董事会秘书。

报告期内思比科高级管理人员未发生变动。

公司已在预案（修订稿）“第四节交易标的基本情况”之“三、交易标的之思比科”之“（三）思比科股权结构、人员结构及高管团队情况”补充披露了上述内容。

③核心技术人员简历及变动情况

思比科共有陈杰、程杰、旷章曲、钟萍4名核心技术人员，简历见本回复“（七）1、（2）思比科”之“②高级管理人员简历及变动情况”，报告期内思比科核心技术人员未发生变动。

公司已在预案（修订稿）“第四节交易标的基本情况”之“三、交易标的之思比科”之“（六）思比科主营业务情况”补充披露了上述内容。

2、本次交易完成后核心管理团队以及研发技术人员的安排意向，请就核心人员变动对公司生产经营的影响提示风险

（1）核心管理团队以及研发技术人员的安排意向

鉴于本次交易转让的标的资产为标的公司股权，本次交易完成后，标的公司及其子公司作为独立法人的身份不会发生变化，标的公司及其子公司将继续履行与其员工的劳动合同，并不因本次交易而导致额外的人员安排问题。根据北京豪威和思比科与上市公司签订的《发行股份购买资产协议》，北京豪威和思比科承诺在本次发行的股份完全解锁前，尽量保持公司及子公司核心经营管理团队和核心技术团队的基本稳定。

韦尔股份董事长虞仁荣自2017年9月起担任美国豪威董事、首席执行官，已参与到美国豪威的日常经营管理工作当中。本次交易完成后，上市公司会根据经营管理需要，另行决定是否委派董事或高级管理人员对标的公司进行管理。同时上市公司将保留标的公司相对独立的运营管理权，主要由原核心管理团队负责日常业务的运营和管理。此外，由于标的公司属于知识密集型行业，核心技术人员是标的公司核心竞争力的重要体现。本次交易完成后，上市公司会利用合理的激励措施来稳定核心技术团队。

公司已在预案（修订稿）“第一节本次交易概况”之“七、本次交易对上市公司的影响”之“（六）本次交易完成后上市公司对标的公司的整合”补充披露了上述内容。

（2）风险提示

公司已在预案（修订稿）“重大风险提示”之“二、标的资产经营风险”补充披露了“十、核心人员变动风险”。具体如下：

“经过多年的发展和积累，标的公司建立了经验丰富、业务娴熟、具备较高素质的核心经营管理团队和技术团队，核心人员的稳定对本次交易完成后标的公司的正常、稳定经营有积极的正面影响。

本次交易完成后，上市公司将采取合理的激励措施，促进核心团队和核心人员的稳定。但若核心人员出现大量流失，则可能对标的公司长期稳定经营及经营业绩产生不利影响。”

3、中介机构意见

独立财务顾问认为：标的公司核心管理团队以及核心技术人员教育背景和知识结构符合CMOS图像传感器行业对高技术人才的要求，且拥有较为丰富的相关行业从业经验；报告期内，标的公司核心管理团队和核心技术人员较为稳定，离职率较低。本次交易完成后，上市公司和标的公司会尽量保持核心管理团队和核心技术人员稳定。因此，本次交易完成后，标的公司因核心人员变动导致经营业绩产生不利影响的风险较低。

三、关于标的资产的历史沿革

（八）请公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号》的规定披露交易标的及其主要资产的历史沿革情况，包括但不限于美国豪威的私有化情况、交易标的的历次股权转让作价情况等。请财务顾问发表意见。

【回复】

1、请公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号》的规定披露交易标的及其主要资产的历史沿革情况，包括但不限于美国豪威的私有化情况、交易标的的历次股权转让作价情况等

（1）北京豪威历史沿革

① 2015年7月设立，注册资本10万美元

2015年5月20日，北京集电及海鸥开曼签署《北京豪威科技有限公司中外合资经营企业合同》和《北京豪威科技有限公司公司章程》，约定共同出资设立北京豪威，投资总额为14万美元，注册资本为10万美元，注册资本由北京集电和海鸥开曼各出资5万美元。

2015年7月8日，北京市海淀区商务委员会出具《关于设立北京豪威科技有限公司的批复》（海商审字[2015]571号），同意北京集电与海鸥开曼设立北京豪威；同意各投资方签署的合营公司合同；批准北京豪威投资总额、注册资本和股权结构；北京豪威出资期限为营业执照签发之日起2年内。

北京豪威设立时的股东出资情况已与北京豪威2016年1月的增资情况一并经普华永道于2016年11月25日出具的《验资报告》（普华永道中天验字[2016]第1588号）验证。根据前述验资报告，北京集电、海鸥开曼实际出资时间符合北京市海淀区商务委员会批复的出资时限。

2015年7月9日，北京市人民政府核发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资京字[2015]8216号）。

2015年7月15日，北京豪威取得北京市工商局海淀分局核发的《营业执照》（注册号：110000450290202）。

北京豪威设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（美元）	出资比例（%）
1	北京集电	50,000.00	50.00
2	海鸥开曼	50,000.00	50.00
合计		100,000.00	100.00

② 2016年1月，增加注册资本至110,000万美元

2015年9月25日，北京豪威召开董事会并作出决议，同意北京豪威投资总额由14万美元增加至190,000万美元，注册资本由10万美元增加至110,000万美元，其中北京集电以折合34,995万美元的人民币现金增加出资；开元朱雀以折合40,000万美元的人民币现金出资；海鸥香港以21,165万美元现汇出资；奥视嘉创以折合13,830万美元的人民币现金出资；同意修改公司章程。

同日，北京集电、开元朱雀、奥视嘉创、海鸥香港及海鸥开曼签署根据本次增资情况修改后的《北京豪威科技有限公司公司章程》和《北京豪威科技有限公司中外合资经营企业合同》。

2015年12月1日，北京市商务委员会核发《北京市商务委员会关于北京豪威科技有限公司增资等事项的批复》（京商务资字[2015]964号），同意北京豪威本次增资事项及各方增资金额；新增注册资本于换领营业执照后2年内缴付；同意本次增资后的北京豪威股权结构；同意各方于2015年对合资合同及公司章程进行的重述。

2015年12月4日，北京市人民政府核发本次变更后的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资京字[2015]8216号）。

2016年11月25日，普华永道出具《验资报告》（普华永道中天验字[2016]第1588号）验证，截至2016年11月8日，北京集电、开元朱雀、奥视嘉创、海鸥香港及海鸥开曼已足额缴纳其已认购的北京豪威注册资本，合计11亿美元，占注册资本的100%。

2016年1月6日，北京豪威取得北京市工商局海淀分局核发的本次增资后的《营业执照》。

本次增资完成后，北京豪威股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（美元）	出资比例（%）
1	开元朱雀	400,000,000.00	36.3636
2	北京集电	350,000,000.00	31.8182
3	海鸥香港	211,650,000.00	19.2409
4	奥视嘉创	138,300,000.00	12.5727
5	海鸥开曼	50,000.00	0.0045
合计		1,100,000,000	100.0000

③ 2016年9月，股权转让

2016年8月25日，北京豪威召开董事会并作出决议，同意北京集电、开元朱雀、海鸥香港以及奥视嘉创将其所持北京豪威股权转让予相关受让方；同意各方就上述股权转让事宜签署股权转让协议；同意修改北京豪威的合资合同和章程。

同日，前述转让方、受让方与北京豪威及其原股东分别就股权转让事宜签署《股权转让协议》。根据各方签署的股权转让协议，本次股权转让的具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让的出资（美元）	转让出资占注册资本的比例（%）	转让对价	每1美元出资转让价格
1	北京集电	嘉兴水木	75,642,965	6.8766	495,000,000元	6.54元
2		嘉兴豪威	75,642,965	6.8766	495,000,000元	6.54元
3		首誉光控	45,844,221	4.1677	300,000,000元	6.54元
4		清控华科	30,562,814	2.7784	200,000,000元	6.54元
5		惠盈一号	25,978,392	2.3617	170,000,000元	6.54元
6		金信华创	18,337,689	1.6671	120,000,000元	6.54元
7		金信华通	12,225,126	1.1114	80,000,000元	6.54元
8		西藏大数	9,168,844	0.8335	60,000,000元	6.54元
9		西藏锦祥	6,112,563	0.5557	40,000,000元	6.54元
10		德威资本	1,528,141	0.1389	10,000,000元	6.54元
11		深圳远卓	1,528,141	0.1389	10,000,000元	6.54元
12		深圳兴平	1,528,141	0.1389	10,000,000元	6.54元
小计			304,100,002	27.6454	1,990,000,000元	—
1	开元朱雀	珠海融锋	175,430,737	15.9482	1,148,001,201元	6.54元
2		芯能投资